

臻鼎科技控股股份有限公司

法人說明會簡報

2021年4月份

2010-2020年經營狀況

單位：新台幣百萬元；%

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
營業收入	34,696	44,280	55,369	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279
營業毛利	4,638	6,993	10,775	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584
稅後淨利	711	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508
歸屬母公司 淨利	711	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095
現金 (註1)	1,797	4,084	8,756	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775
折舊及攤銷 費用	2,807	3,008	3,375	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405
資本額 (註2)	6,464	6,699	7,034	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470
股東權益報 酬率	5.54%	15.34%	21.27%	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%
負債比率	69.70%	67.03%	66.28%	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%

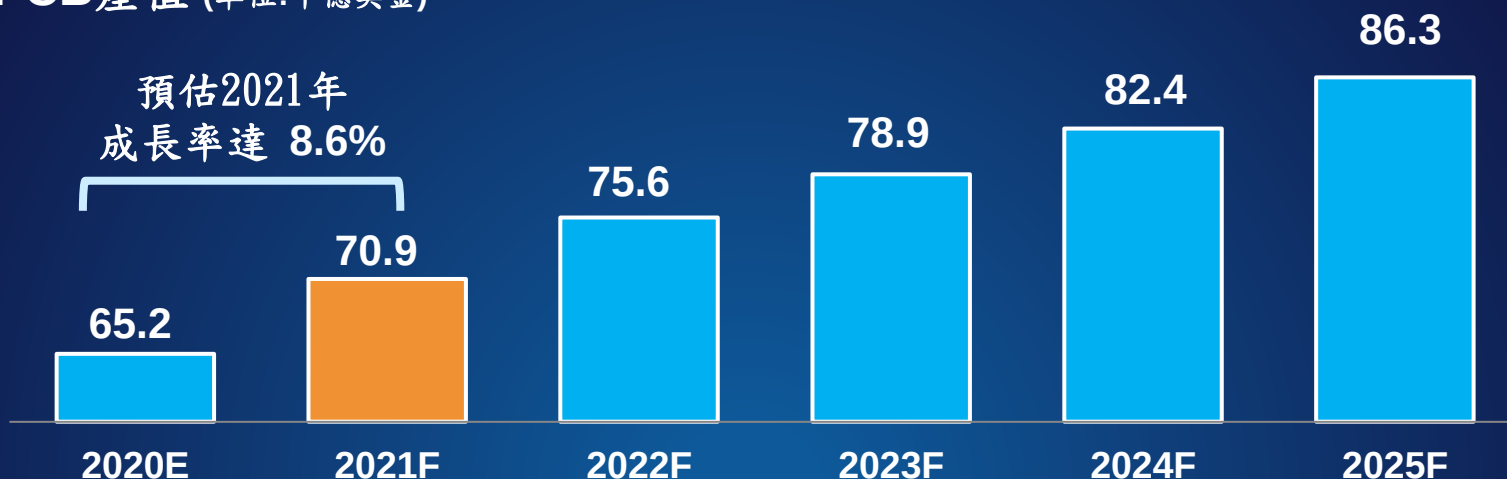
註：

(1) 現金包含現金及約當現金與按攤銷後成本衡量之金融資產。

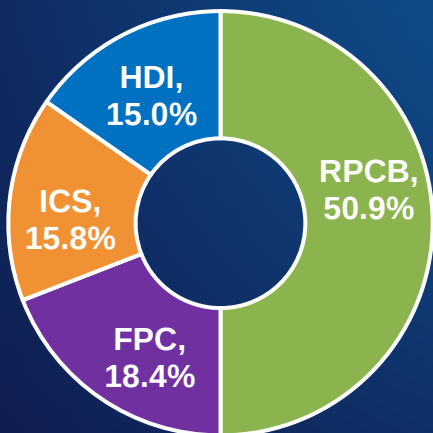
(2) 2020年11月完成發行新股方式取得先豐 100%股權 (44,819,274 股)，資本額增加至新台幣9,470百萬元。

全球PCB市場規模

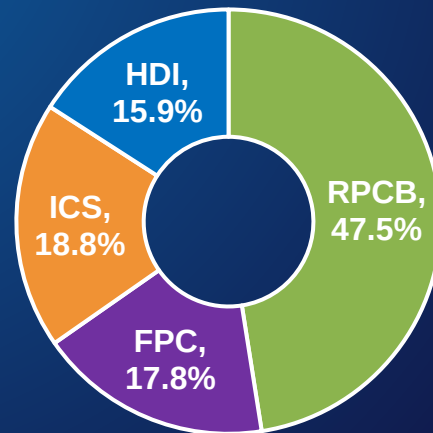
全球PCB產值 (單位:十億美金)



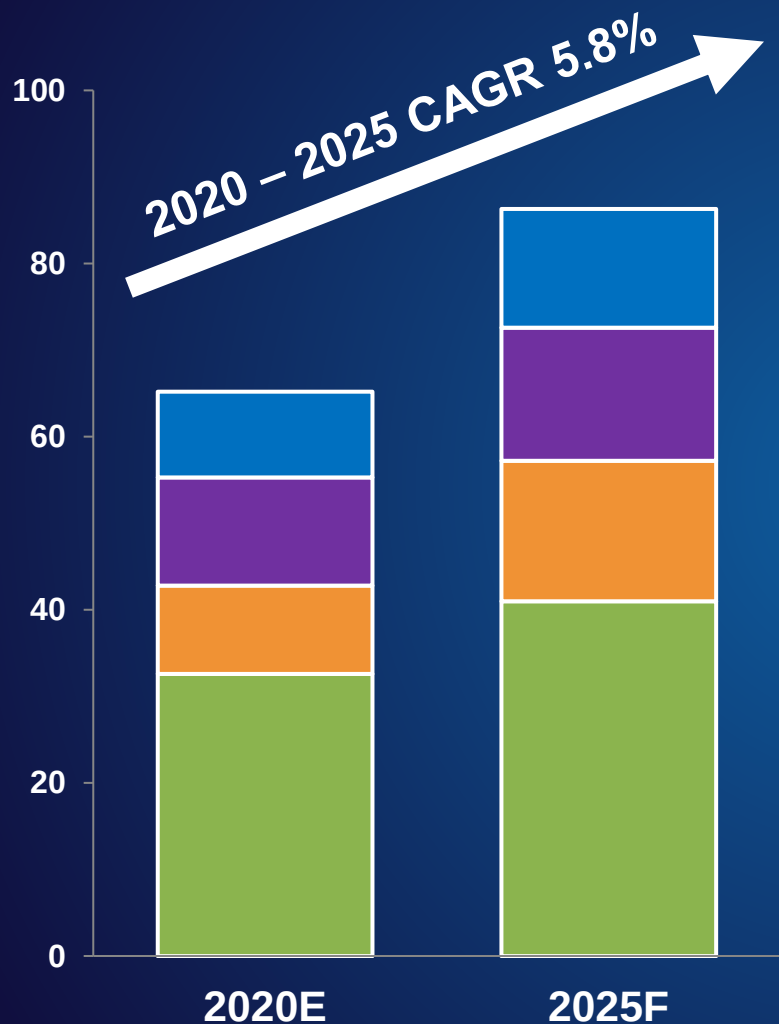
2020年PCB產品佔比



2025年PCB產品佔比



全球PCB市場成長動能



PCB產品		2020年 產值	2025年 產值	2020-2025 複合成長率
	HDI	9.9	13.7	6.7%
	FPC	12.5	15.4	4.2%
	ICS	10.2	16.2	9.7%
	RPCB	32.6	41.0	4.7%
總計		65.2	86.3	5.8%

2020年

■RPCB ■ICS ■FPC ■HDI

2004年



深圳福永廠



深圳第一園區



深圳第二園區



秦皇島園區



淮安第一園區



淮安第二園區



淮安第三園區

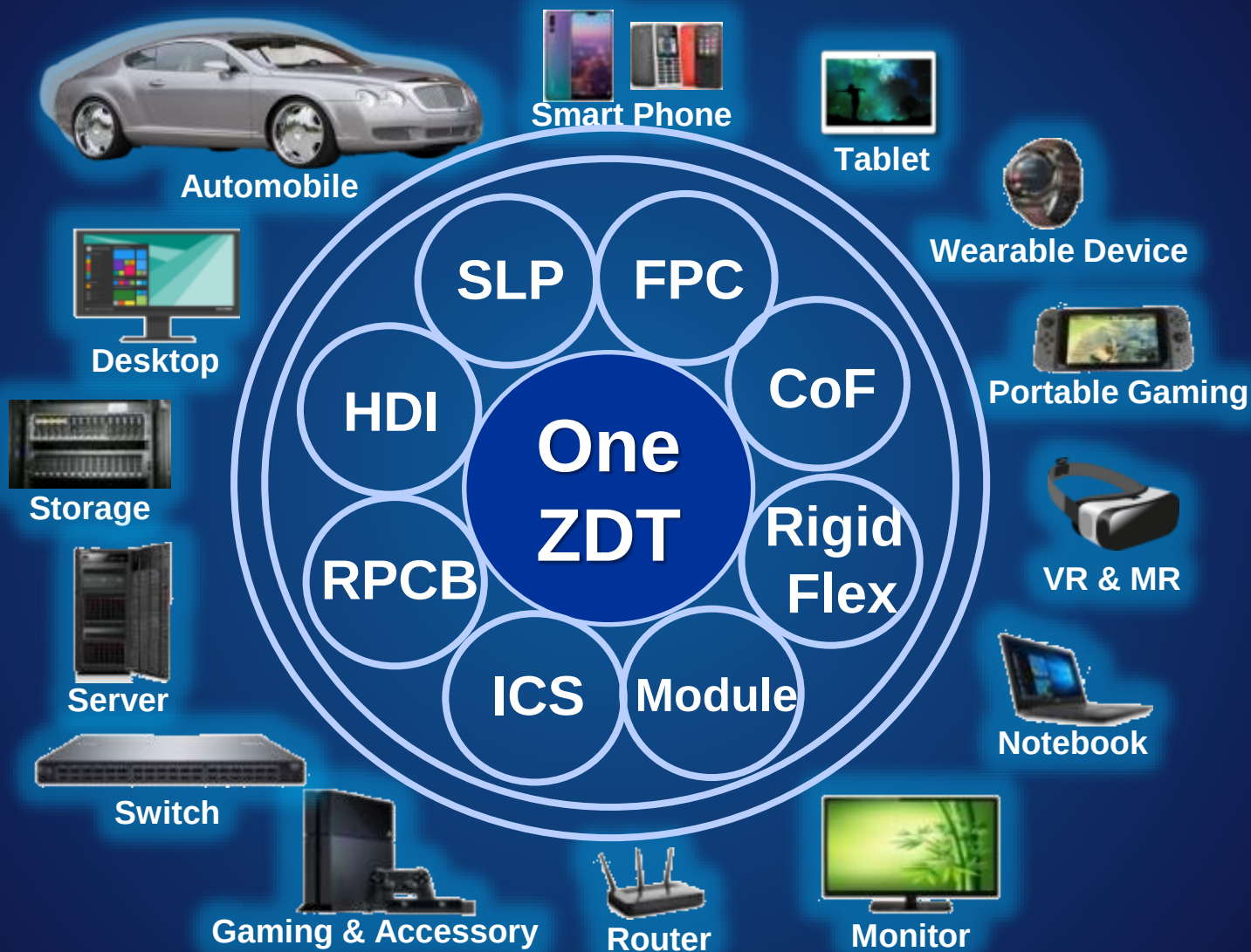


印度清奈園區



桃園(先豐通訊)

One ZDT

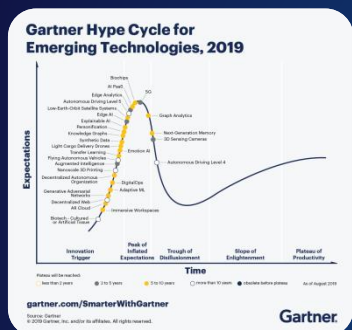


臻鼎產品開發佈局

基於通訊技術延伸與拓展

承載AI+分析及數位生態智慧硬體

人體機能增進生物科技



AI 5G → 6G
Sensing IoT

後經典運算
及通訊

感測與
行動力

先進人工智慧
與分析技術

數位生態系

擴增
人體機能

生醫電子

先進材料

汽車電子

生物感測

車載ADAS

能源動力

熱管理

存儲雲端

網路通訊

主機板(背)

觸控顯示

射頻天線

聲音控制

攝像視訊

消費性電子

可穿戴電子

通訊技術

高散熱

- 內埋銅塊/填孔/塞孔
- 厚銅/導熱PI/石墨片
- 散熱系統

高頻高速

- Low Dk/Df材料
- 混壓/高溫壓合
- 射頻天線設計與模擬
- 射頻探針台/天線微波暗室

高密度

- MSAP/ SAP/ FAP
- 微孔/跳孔/疊孔/埋孔/填孔
- ETS/ Trace on via

集成化

- FCBGA/ TDDI PCB
- SLP Main Board/ Hybrid-Flex
- AiP/SiP/ SoC/SoF
- SMT/ Hotbar/ ACF/ TCB

高可靠性

- 可靠性設計及材料選用
- 可靠性實驗儀器

多層互連

- 定深鑽/背鑽
- HLC/ Cavity
- ELIC/銅膏塞孔
- 開蓋 (定深/自動化)
- 高平整度

薄型化

- 薄核心層/薄銅/薄覆蓋膜
- 元件內埋
- RTR/ Contact free

微型化

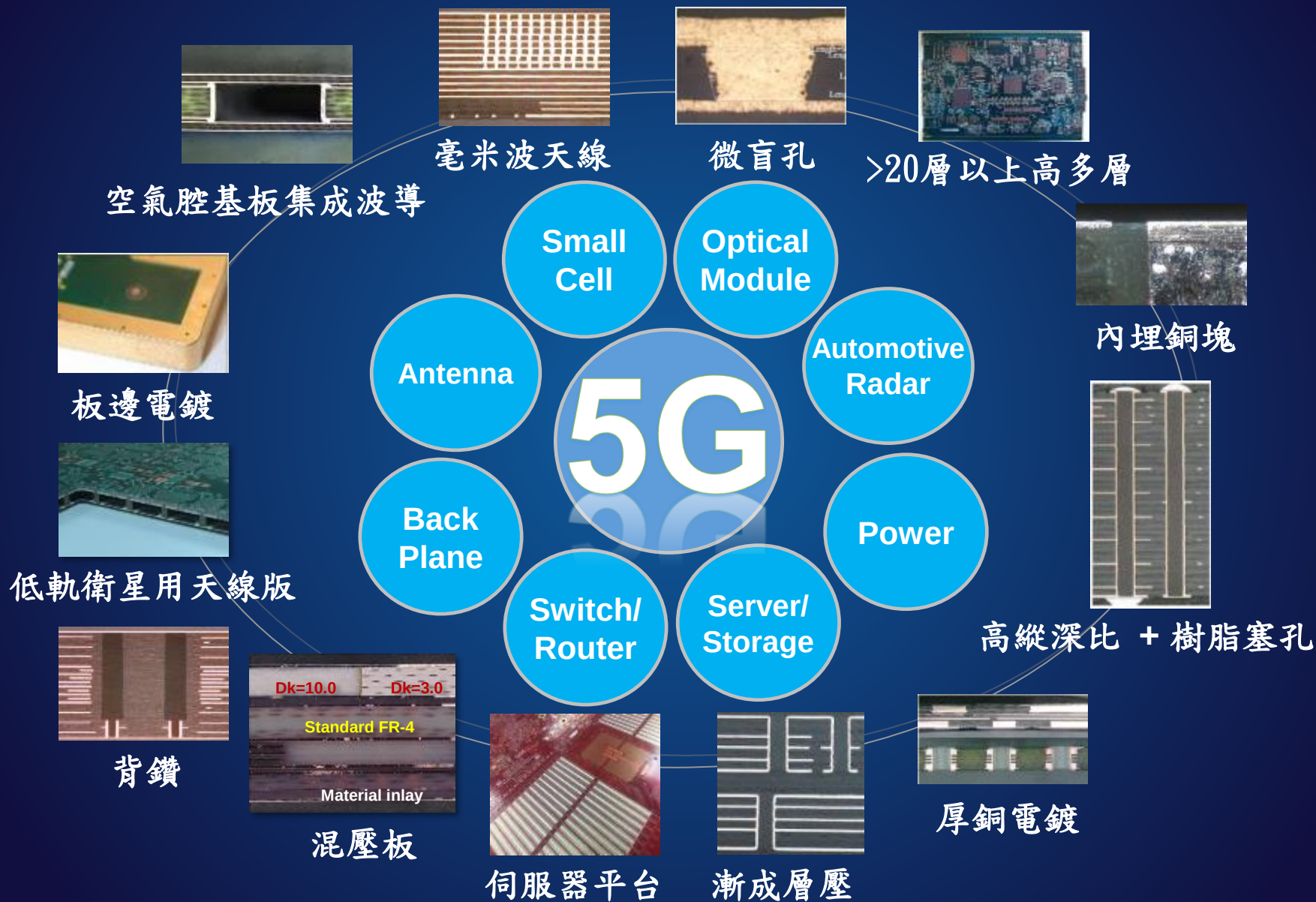
- 元器件01005/ 03015
- Fine Pitch

精緻化

- 3D flex
- 透明/可拉伸
- 噴印技術



5G PCB產品技術佈局



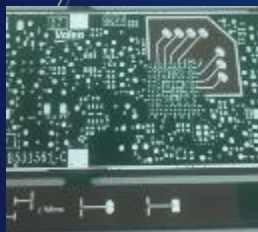
車載產品技術佈局



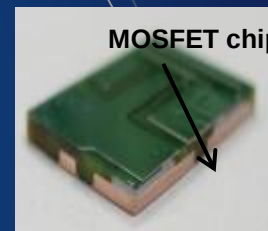
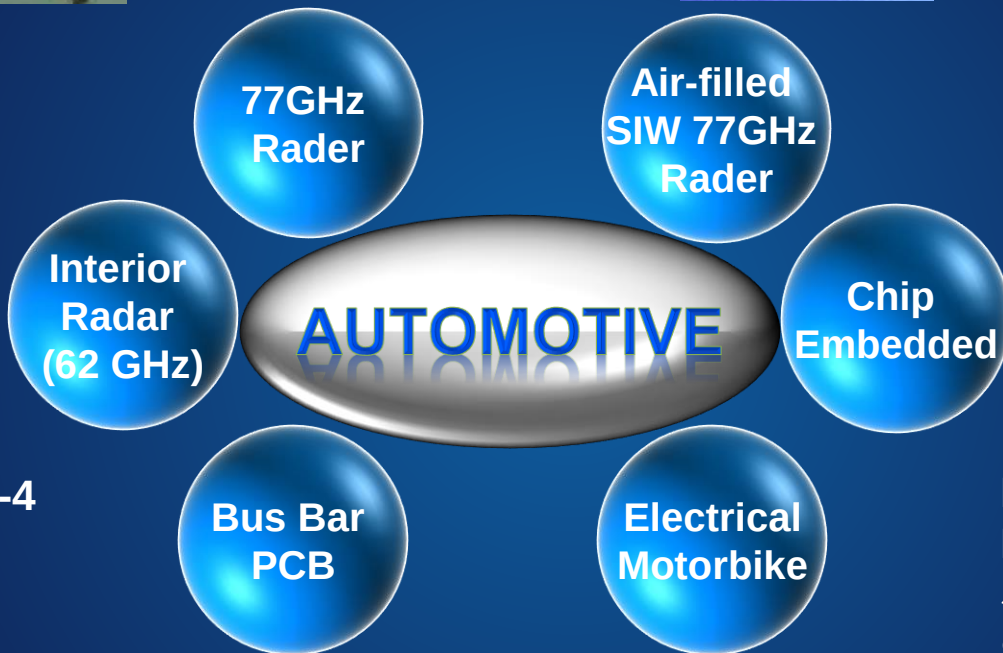
八層板, 定深鑽盲孔設計
8 Layers, Deep control
via (RO3003+FR-4)



波導內埋設計槽體天線
Embedded Waveguide
Slot Antenna



Taconic
TSM-DS3 + FR-4



芯片內埋高功率模塊
Embedded High Power
Modulus
銀燒結
Silver Sintering
銅塊散熱
Cu-coin Heat Sink

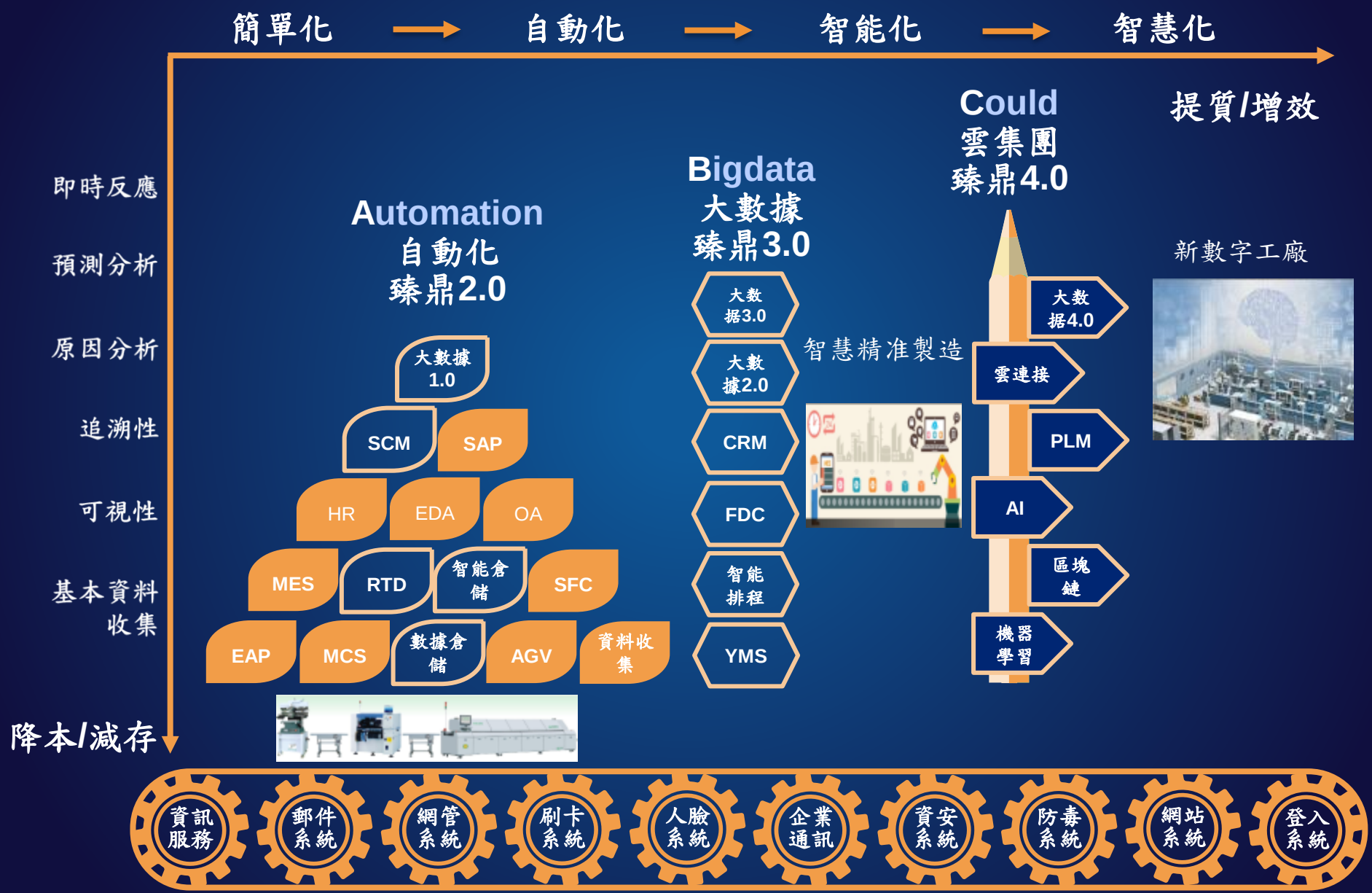


內埋匯流排
Bus Bar PCB



高功率4層板(內埋17顆銅塊)
High Power 4 Layers
(17 Embedded Cu-coins)

智慧臻鼎4.0計劃



Q&A